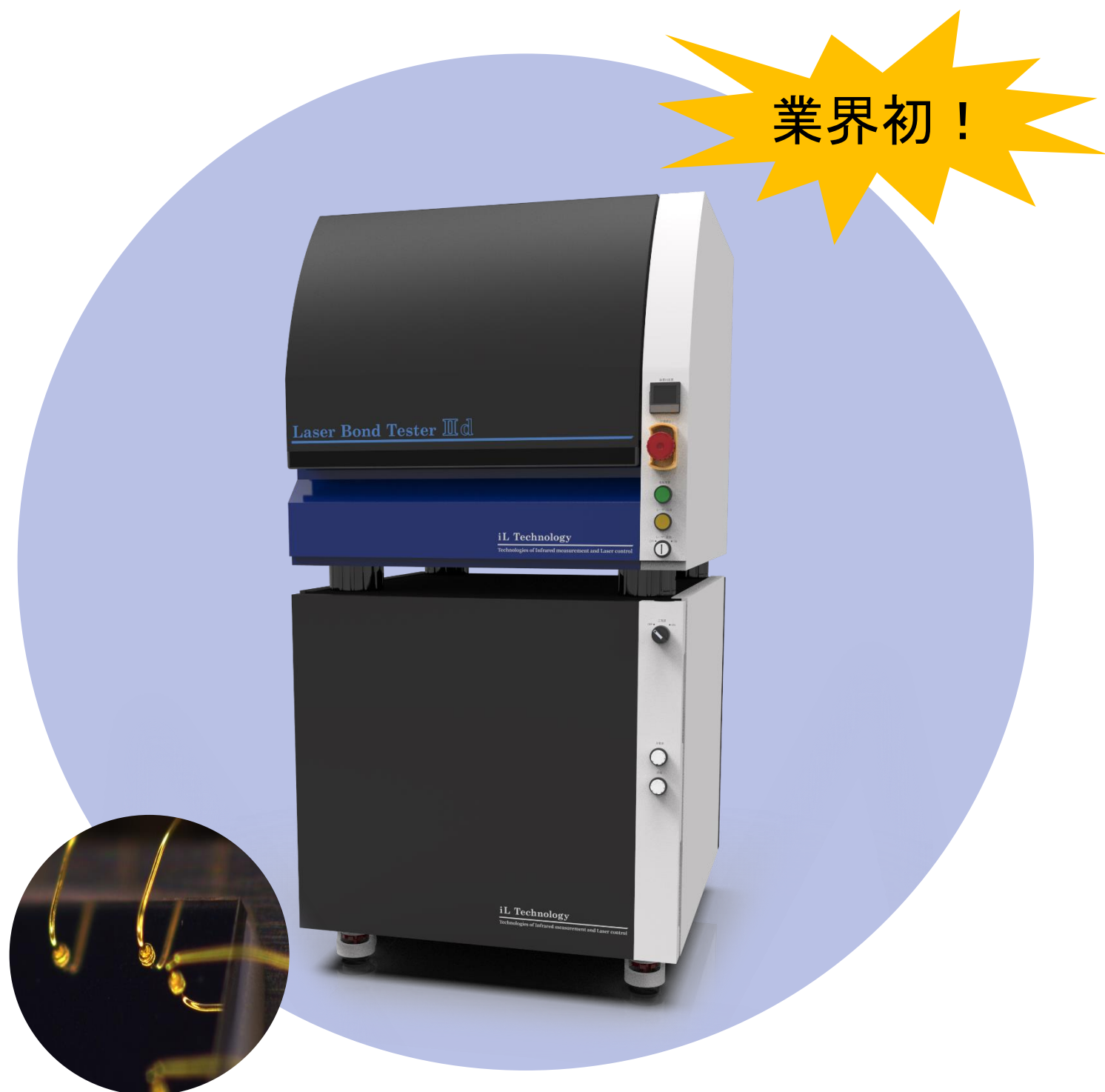


非破壊

レーザーボンドテスター

## Laser Bond Tester II d

業界初！



< 手動測定 >

金ワイヤボンドの 非接触 非破壊 瞬時測定 を初実用化！

## 概要仕様

測定方法	レーザー周期加熱式接合界面測定法 *3)
測定対象	金または銅のワイヤ接合界面 *1)
測定結果表示(接合面積)	接合面積及び接合係数(補正定数を設定)、熱時定数、位相、良否(設定値による)、位相変位グラフ
被測定対象ワイヤ径	Φ15μm～Φ40μm *1) (Φ15μmの場合は、加熱部位幅がΦ20μm以上であること)
加熱用レーザー	スポット径: Φ20μm *1、2)、半導体レーザー
測定時間	ボンド当りの実質測定時間: 1ms～30ms程度/1ボンド
測定領域	300mm(X)・300mm(Y)
画像処理機能	全体カラー画像、拡大カラー画像、手動寸法計測、測定点移動アシスト(全体⇒拡大⇒ズーム)
電源	単相AC200V 20A/typ.(要接地端子)、その他は御相談下さい
使用レーザークラス	クラス4: JIS C 6802:2018 / IEC 60825-1:2014 準拠
装置レーザークラス(通常運用時)	クラス1相当
装置安全基準	ISO13849-1 / JIS B 9705:2019 準拠
装置本体外形寸法	700(W)・750(D)・1390(H)
重量	約280kg
動作環境	温度: 20～30℃・湿度: 85%RH以下・粉塵無き事

※1) 測定対象毎に測定条件や加熱レーザーの調整などが必要です。

※2) 本装置のレーザーはクラス4製品です。ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けて下さい。

※3) 測定方法は、株式会社ジェイテクトのpatentに基づいています。

※4) 本装置は温度調整ユニット用に工業用純水が必要です。(内部循環式)

※5) 本装置は機能・性能向上の為、お断りなく仕様の変更される場合があります。



販売代理店



株式会社 南陽

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号

TEL: 092-473-7711

URL: <https://www.nanyo.co.jp>

製造元

**iL Technology Corporation**

アイエルテクノロジー株式会社

愛知県岡崎市針崎1丁目1番地13

TEL: 0564-73-2005

URL: <http://www.il-tech.jp>